



①



③



②

现场签约项目57个,总金额5.9亿元 硬科技扎堆北京科博会

本报讯(记者 张伟)5月8-10日,以“科技引领 创享未来”为主题的第二十八届中国北京国际科技产业博览会(CHITEC,以下简称“北京科博会”)在北京国家会议中心举办。

本届北京科博会云集800余家国内外企业和机构,发布各类成果148项,组织对接洽谈活动37场次,现场签约项目57个,总金额5.9亿元;吸引72个国家和地区7万余人次现场参观观展,50余万人次线上观展。

本届北京科博会紧扣国家战略和产业发展需求,集中展出一批全球首创、自主可控的关键核心技

术,全方位展示我国科技强国建设新成效。同时,北京科博会顺应科技消费新趋势,推动“文商旅体展”深度融合,让高精尖技术产品走进大众生活,以会展流量激活城市消费。

据悉,本届北京科博会在稳步推进运营机制改革基础上,实现“办出特色、办出水平”目标。据介绍,下一步北京科博会将坚持国际化、市场化、专业化、数字化、绿色化办展理念,围绕首都优势产业、未来产业、新兴产业持续发力,努力打造高水平、国际化科技展会,有力服务北京(京津冀)国际科技创新中心建设。



④



⑤

①航景创新FWH-3000型2.5吨级纵列式双旋翼无人直升机

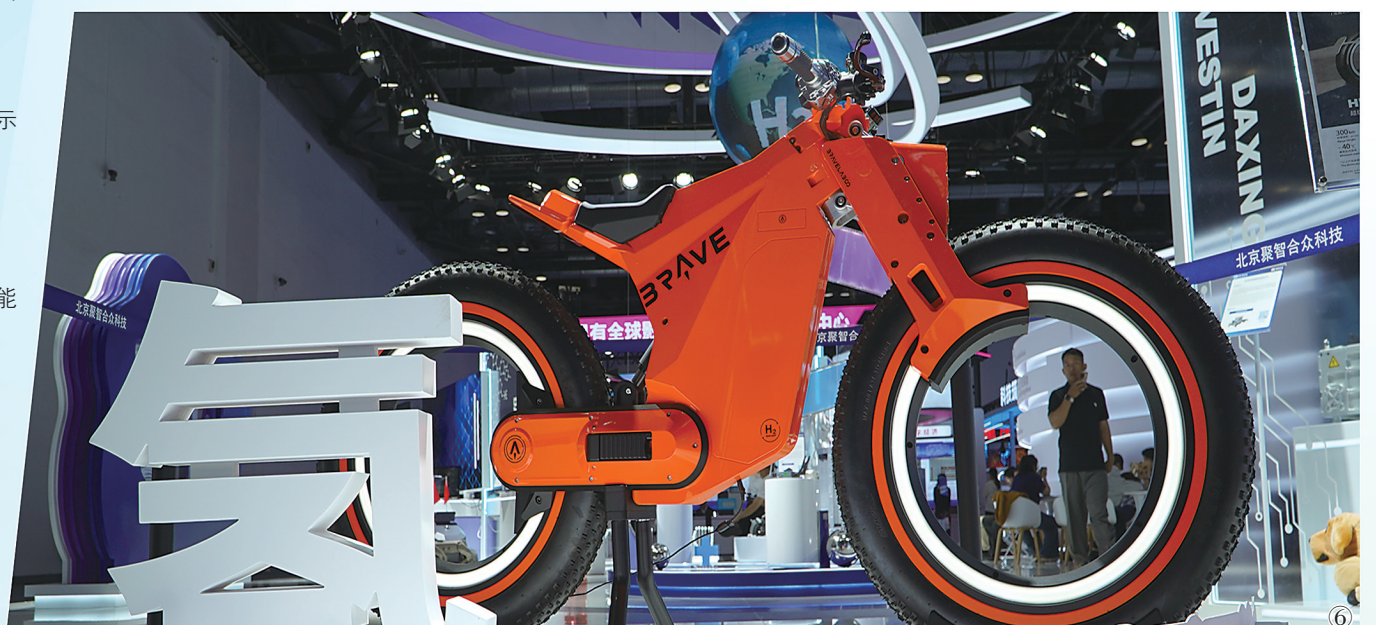
②乐聚通研人形机器人秀书法

③术锐蛇形臂单孔腹腔镜手术机器人演示剥鹌鹑蛋壳

④世航智能“虎鲸”海洋机器人

⑤妙策士AI智能理疗机器人进行推拿

⑥北京聚智合众科技HE-160超级氢能混合动力全地形两轮车



⑥

本版图片均为孙合西/摄